解 説

MEMS デバイスを用いた微小有機分子性結晶の 低温熱伝導率測定

岡田 悠悟^a, 宇野 真由美^b, 竹谷 純一^{a,b} ^a東京大学大学院新領域創生科学研究科 ^b大阪府立産業技術総合研究所

(受取日:2013年9月1日,受理日:2013年9月24日)

Low-Temperature Thermal Conductivity of Submilimeter Organic Molecular Crystals

Yugo Okada^a, Mayumi Uno^b, and Jun Takeya^{a,b} ^aDepartment of Frontier Sciences, The University of Tokyo, Kashiwa, Chiba 277-8561, Japan ^bTechnology Research Institute of Osaka, Izumi, Osaka 594-1157, Japan

(Received Sep. 1, 2013; Accepted Sep. 24, 2013)

We disclose a method of quantitatively characterizing crystalline defects by measuring low-temperature thermal conductivity in relatively clean organic molecular crystals. A new thermodevice is developed to measure low-temperature thermal conductivity of organic single crystals that often grow only minute. The technique of Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) is employed, so that samples with the length from a few tens to several hundreds of μ m can be mounted. Thermal conductivity of rubrene single crystals is measured down to 0.5 K in order to estimate the density of crystalline defects quantitatively from their phonon mean-free paths. The temperature profile of the rubrene crystals exhibit a pronounced peak at ~ 10 K in the thermal conductivity due to very long mean-free paths of their phonons, which indicates extremely low-level defect density in the region of 10^{15} - 10^{16} cm⁻³ depending on different growth methods. The crystals grown from the gas phase tend to have less defects than those grown from solution.

Keywords: thermal conductivity, organic molecular crystals, Micro Electro Mechanical Systems.



岡田 悠悟 Yugo Okada E-mail: y-okada@organicel.k.u-tokyo.ac.jp



宇野 真由美 Mayumi Uno E-mail: uno@tri-osaka.jp



竹谷 純一 Jun Takeya E-mail: takeya@k.u-tokyo.ac.jp

1. はじめに

有機分子性結晶は、近年、有機電界効果トランジスタ (OFETs)などの有機エレクトロニクス材料¹⁻³⁾や非線形光 学材料⁴⁾としての有用性が示され,注目度が高まっている。 しかし、これらの素子特性には、 10^{15} cm⁻³程度の少量の欠陥 や不純物の存在が大きな影響を及ぼすにもかかわらず、こ うした高純度の有機単結晶の品質を定量的に評価する手法 は確立されていない。現在、有機電界効果トランジスタの キャリア移動度は、演算素子への実用上目標とされる値で ある $\mu \sim 100$ cm² V⁻¹ s⁻¹に迫っており、有機エレクトロニク スの実用化へ向けたいっそうの移動度向上のため、移動度 に影響を与える様々なパラメーターの評価は非常に重要に なっている。

有機トランジスタ中のキャリア伝導と同様に、一般に輸送現象は結晶欠陥や不純物による散乱確率を直接反映する 事に着目し、本研究では、フォノンの平均自由行程が関与する熱伝導率の測定によって、結晶欠陥の密度を評価する実験を行った。また、熱伝導率測定は、結晶の表面の様子を観測する光学的測定などとは異なり、バルク内部の欠陥の情報を得る事ができるという点でも有機単結晶の品質評価に 有効である。フォノンの熱伝導率は高温領域では熱励起されたフォノンによる散乱が支配的なのに対し、10~20 K 以下では、主に結晶欠陥によって散乱を受けるので、この低温領域の熱伝導率を測定する事によって、欠陥密度を評価する事ができる。

2. 熱伝導率測定

Fig.1 に示すように、DC 熱伝導率は熱浴に取り付けた試料にヒーターと 2 つの温度計を取り付け、ヒーターを発熱 させて試料中に定常熱流を流し、発生する温度差を読み取 る事で測定される。ヒーターから発生するジュール発熱量 Q が試料を通って熱浴へ定常的に流れ込んでいる状態で、 試料と熱的に接触している 2 つの温度計の温度 T_1, T_2 を測 定し、温度差 ΔT を求め、熱伝導率の定義の式

$$\kappa = \frac{Q}{\Delta T} \frac{L}{S} \tag{1}$$

を用いて熱伝導率 κ を求める。ここで、Lは2つの温度計の間の距離、Sは試料の断面積である。熱伝導の良いサンプルでは、同じ温度差をつけるために多量の熱流が必要である。逆に、断熱性の良い(熱伝導率の悪い)サンプルでは、熱流がほとんどなくても大きな温度差をつける事ができる。サンプル温度としては $T_1 \ge T_2$ の平均を用いた。Qを大きくしてサンプルの温度差を大きくすると、シグナルは大きく



Fig.1 A schematic diagram of the steady-state thermal conductivity measurement for bulk organic crystals.

なるが、熱伝導率の鋭い温度変化が現れにくくなる欠点が 生じる。このため、典型的には ΔT をサンプル温度の数%程 度になるように Qを調節しながら、各温度において κ を測 定した。

3. 熱伝導率測定用 MEMS デバイスの開発

熱伝導率は結晶構造を反映した方向性を有する輸送係数 なので、格子欠陥や不純物が少ない純良な単結晶を測定試 料として用いるのが望ましい。しかし、フローティングゾ ーン法などによって比較的容易に mm 級の純良な単結晶が 得られる無機化合物とは異なり、大きく高品質な有機結晶 を成長させるのは一般により困難である。このため、これ までの手法をそのまま分子性結晶に用いる事はできない場 合が多かった。本研究では、この問題を解決するため、100 μm 級の微小結晶をマウントするだけで簡便かつ精密に熱 伝導率を測定できるよう、3 次元微細加工技術である MEMS 技術を用いて熱伝導率測定用デバイスを作製した。 MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) とは、μm オーダ ーの微細構造を1つの Si 基板上に集積して構築し、様々な 機能性を持った立体構造を形成する手法の事である。

熱伝導率測定用 MEMS デバイスは集積回路作製技術で あるフォトリソグラフィ,薄膜作製,Si エッチングの各技 術を組み合わせて作製された。Fig.2 に熱伝導率測定用 MEMS デバイスの顕微鏡写真を示す。 MEMS 技術を用いた 熱伝導率測定用デバイスは、Si 基板上に SiO₂層と SiN 層か らなる薄膜(メンブレン)を形成し、基板中央部にフォト リソグラフィによってヒーター及び温度計となる ZrN 薄膜 と金電極をパターンし、その後、ヒーター及び温度計のみ を残して選択的に Si 基板およびメンブレンをエッチング し、試料を取り付ける部分を中空構造にして作製した。ZrN は cernox[®]温度計などにも使われている材料であり, 室温 から He 温度までの広い温度範囲で抵抗温度計として使用 できる。ヒーター・温度計として用いる ZrN 薄膜は幅 5 μm, 厚さ200 nm, それを保持するメンブレンは幅15 µm, 厚さ1 µm以下と非常に薄く、また、ZrN薄膜もメンブレンもアモ ルファスであるため、熱伝導率は小さい。このため、ヒータ ー・温度計構造からの熱リークはほとんど無視できる構造 である。

4. ルブレン単結晶の低温熱伝導率

今回,高移動度の有機半導体材料として知られている有 機分子性結晶ルブレンを熱伝導率測定による結晶欠陥の評



Fig.2 Photograph of the developed MEMS device to measure thermal conductivity of sub-millimeter organic crystals.

価法のサンプルとして選択し、OFETs 用の単結晶作製手法 として標準的な Physical Vapor Transport 法 ⁵⁻⁷⁾ 及び 2 種類の 有機溶媒(アニリン及び *p*-キシレン)からの再結晶⁸⁾ によ って成長させたサンプルを評価した。 physical vapor transport 法は,温度コントロール可能な管状電気炉を 2 つ 連結し、電気炉高温部(298 °C)で昇華させた分子を Ar ガ スフローによって電気炉低温部(240 °C)へ輸送し、そこ で結晶化させるという気相からの結晶成長法である。⁵⁾ ア ニリン及び *p*-キシレン溶液からルブレンを再結晶させる際 には、恒温槽の温度を非常にゆっくりと下げ、多結晶化を 防いだ。

フォノンの熱伝導率*k*は,格子熱容量 *C*,フォノン速度 *v*, フォノンの平均自由行程1に比例し,

$$\kappa = \frac{1}{3}Cvl \tag{2}$$

となる。主にフォノンによって熱が伝えられる絶縁体では、 平均自由行程を決定する要因は、低温領域ではサンプル固 有の欠陥による散乱、高温領域ではフォノンーフォノン散 乱である。フォノンの平均自由行程は、低温領域では欠陥 密度によって制限されるためにほとんど一定で、高温領域 ではフォノンーフォノン散乱の増大によって温度上昇に伴 って急激に減少する。格子熱容量は、温度上昇によって温 度の3 乗に比例して増加する。このため、フォノンの熱伝 導率は、平均自由行程と格子熱容量がクロスオーバーする 温度域においてピークを持つ。ルブレンのようなフォノン によって熱が伝導される物質の熱伝導率は Fig.3 のように、 低温でサンプルの欠陥に依存するフォノン由来のピーク構 造を示し、十分にフォノンーフォノン散乱が強くなった高 温ではサンプル依存性がなくなり、物質固有の熱伝導率を とる。



Fig.3 Typical temperature dependence of phonon thermal conductivity.

3 種類の異なる手法で結晶成長させたルブレン単結晶の 熱伝導率を Fig.4 に示す。physical vapor transport 法による サンプルでは、10 K 付近の熱伝導率に有機分子性結晶では ほとんど報告例がないほど明瞭なフォノン由来のピーク構 造が現れている。⁹⁾ この低温領域における熱伝導率のピー クは、フォノンの平均自由行程が分子間距離より桁違いに 長い事を示しており、気相成長させたルブレン単結晶の純 良性を反映しているといえる。一方、液相から成長させた ルブレン単結晶は2 種類とも physical vapor transport 法によ るものより低温における熱伝導率が小さく、より欠陥密度 が大きい事が分かる。この結果は、気相成長、及び、液相成 長したルブレン単結晶を用いて作製した FET の移動度測定 の結果(気相成長: $\mu \sim 10 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$) と定性的に一致している。



Fig.4 Thermal conductivity of three rubrene crystals grown by different techniques. Sample A is grown by PVT while B and C are from aniline and *p*-xylene solutions, respectively. The inset is a magnified view to show the low-temperature peak of the phonon thermal conductivity.

5. 低温熱伝導率測定による欠陥密度の評価

次に、欠陥密度について定量的な議論するため、平均自 由行程と同様に熱伝導率に関与している格子熱容量を測定 した。ルブレンの熱容量 C は Fig.5 に示すように低温では デバイモデルに従い、

$$C = \beta T^3 \tag{3}$$

$$\beta = \frac{12\pi^4}{5} nk_B \frac{1}{\theta^3} \tag{4}$$

となる。ここで、 β は格子比熱係数、T は温度、 $n = 1.5 \times 10^{27}$ m⁻³ は分子密度、 $k_{\rm B}$ はボルツマン定数、 θ はデバイ温度である。Fig.5 の勾配から $\beta = 21 \text{ J/m}^3 \text{K}^4$ なので、デバイ温度は $\theta \sim 63 \text{ K}$ と推定される。フォノン速度vは、

$$v^{3} = \frac{\left(k_{B}\theta\right)^{3}}{6\pi^{2}\hbar n} \tag{5}$$

となるので, v ~ 2100 m/s と推定される. ここで, *l*はプラン ク定数である。



Fig.5 Specific heat of sample A as a function of T^{3} at low temperatures.

Fig.6に示すように、低温領域における熱伝導率の温度依存性は、温度の2乗に比例しており、これはフォノンを散乱する主な要因が結晶格子のディスロケーションによるものである事を示している。¹⁰⁾格子欠陥によって平均行程が制限されている場合、平均自由行程1は、

$$l = \frac{1}{N_{ld}} \frac{2\pi v}{\gamma^2 B^2 \omega} \tag{6}$$

となる。ここで、 N_{ld} は単位面積あたりのラインディスロケ ーション密度、 ν はフォノン速度、グリュナイゼン定数 γ ~ 2, バーガースベクトル B ~ 1 nm (格子間距離オーダー)、 ω は フォノン振動数であり、典型的なエネルギースケールは温 度の 1/3 程度である。¹⁰⁾ 熱伝導率 κ は、Eq.(2)で表されるので、 Eq.(2),(3),(6)から、

$$\kappa = \frac{1}{N_{ld}} \frac{\hbar}{k_B} \frac{2\pi\beta v^2}{\gamma^2 B^2} T^2 \tag{7}$$

となり、熱伝導率は温度の2乗に比例する。この事は、フォ ノンの散乱の原因がストレインディスロケーションタイプ の格子欠陥であることを意味している。結晶系を単純化し て三次元の欠陥密度 N^Dを N_D² = N_{ld}³として, **Fig.6**の勾配か ら欠陥密度及びフォノン平均自由行程 1 を求めた所, physical vapor transport 法によって得たサンプルでは N_D = 2.5×10¹⁵ cm⁻³, *l* ~ 60 µm, アニリン溶液からの再結晶で得 たサンプルでは $N_D = 5.1 \times 10^{15}$ cm⁻³, $l \sim 30$ μm であり, ルブ レン分子 105個当たり1 欠陥程度と非常に高い周期性を持 つ事が分かった。このため、特に physical vapor transport 法 によるサンプルでは、低温領域において、有機分子性結晶 ではまれな顕著なフォノンピークを示すと考えられる。⁹ また, p-キシレン溶液からの再結晶で得たサンプルはフォ ノンピークを示さない事から、このサンプルの欠陥密度は 相当大きく、欠陥密度が再結晶に用いる溶媒(~結晶の成長 速度)に大きく依存している事が分かる。この欠陥密度は, ルブレン単結晶を用いたダブルゲートFET測定から求めら れた結晶中のトラップ密度 $N_T \sim 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ に近く,¹¹⁾ ルブレ ン単結晶中のディスロケーションが周囲とのポテンシャル の違いによって電気的なトラップとしても働いている可能 性を示唆している。



Fig.6 Thermal conductivity of rubrene crystals sample A and B as a function of T^2 at low temperatures.

文 献

- E. Menard, V. Podzorov, S.-H. Hur, A. Gaur, M. E. Gershenson, and J. A. Rogers, Adv. Mater. (Weinheim, Ger.) 16, 2097(2004).
- J. Takeya, M. Yamagishi, Y. Tominari, R. Hirahara, Y. Nakazawa, T. Nishikawa, T. Kawase, and T. Shimoda, *Appl. Phys. Lett.* **90**,102120 (2007).
- C. Reese, W.-J. Chung, M.-M. Ling, M. Roberts, and Z. Bao, *Appl.Phys. Lett.* 89, 202108 (2006).
- T. Matsukawa, Y. Mineno, T. Odani, S. Okada, T. Taniuchi, and H. Nakanishi, J. Cryst. Growth 299, 344 (2007).
- 5) C. Kloc, P. G. Simpkins, T. Siegrist, and R. A. Laudise, J. Cryst. Growth 182, 416 (1997).
- V. Podzorov, V. M. Pudalov, and M. E. Gershenson, *Appl. Phys.Lett.* 82, 1739 (2003).
- J. Takeya, T. Nishikawa, T. Takenobu, S. Kobayashi, Y. Iwasa, T. Mitani, C. Goldmann, C. Krellner, and B. Batlogg, *Appl. Phys.Lett.* 85, 5078 (2004).
- T. Matsukawa, Y. Takahashi, T. Tokiyama, K. Sasai, Y. Murai, N. Hirotai, Y. Tominari, N.Mino, M.Yoshimura, M. Abe, J. Takeya, Y. Kitaoka, Y. Mori, S. Morita, and T. Sasaki, *Jpn. J. Appl. Phys.* 47, 8950 (2008).
- 9) K. Torizuka, H. Tajima, and T. Yamamoto, *Phys. Rev. B* **71**, 193101(2005).
- 10) R. Berman, *Thermal Conduction in Solids* (Oxford University Press, Oxford, 1976).
- J. Takeya, J. Kato, K. Hara, M. Yamagishi, R. Hirahara, K. Yamada, Y. Nakazawa, S. Ikehata, K. Tsukagoshi, Y. Aoyagi, T. Takenobu, and Y. Iwasa, *Phys. Rev. Lett.* **98**, 196804 (2007).